



# Disclosure 信息披露

2019年3月25日 星期一  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

# B16

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2019-021

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函的 回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月8日下午收到上海证券交易所《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证证监[2019]1037号),针对问询函的问题,特作回复如下:

一、关于公司业绩下滑及股权激励:

问题1、年报披露,本年度业绩出现下滑。2018年公司实现营业收入5.66亿元,较去年同比减少9.95%;实现归母净利润7112.48万元,较去年同比减少25.67%;实现扣非归母净利润2,464.14万元,较去年同比减少63.53%。请公司结合行业发展趋势、产品应用范围、技术水平、经营模式、销售及采购方式、客户拓展、毛利率变动等,说明公司2018年主营业务大幅下滑的原因。

回复说明:

1、公司的主营产品及应用领域

公司专注于传感器领域的先进封装技术服务,通过十多年的深耕细作拥有多样化的先进封装技术,封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片等,主要应用于以智能手机为代表的电子产品领域。

2、相关应用领域的发展前景

封装产品的主要应用领域为电子产品,受智能手机行业市场前景影响较大。根据Klener Perkin-averre的《Internet Trends report 2017,2010-2014年,全球智能手机出货量同比增长28%以上,2015年增速下降10%,2016年增速下降3%,又根据全球市场调研机构TrendForce报告称,2015年全球智能手机出货量12.93亿部,同比增长10.32%;2016年全球智能手机出货量达到13.62亿部,同比增长4.7%;2017年全球智能手机出货量9.24亿,同比增长不足1.5%;而Strategy Analytics最新发布的研究报告指出,2018年全年智能手机出货量下降5%,智能机行业首次出现全年下滑。

智能手机出货量也呈现与全球市场类似的趋势,且在2017年下半年首次出现下滑,并在2018年4月跌幅达到了25%以上。从以上全球范围内智能手机的发展趋势来看,智能手机行业市场已经接近饱和,由增量市场转向了存量市场,由增量市场转为创新驱动。同时,随着消费升级电子产品,消费者对智能手机的需求不断升级,如生物身份识别技术在高端智能手机领域不断创新发展,特别是人脸识别的兴起,对指纹识别技术的应用范围与前景领域被拓展。

公司主营封装的产品为影像传感器、指纹传感器等产品,相关产品80%以上应用在以智能手机为代表的电子产品领域。影像传感器、指纹传感器的封装收入占公司营业收入的比重为94.6%,基于以上产业环境,公司业务面临的市场竞争压力日渐激烈,业务规模出现下滑,使得公司影像传感器、指纹传感器的封装出货额降低了7.26%,综合平均毛利率下降了17.11%。综合导致公司的营业收入较2017年降低了2,655万元,降幅为9.95%。上述主营业务下滑的主要原因如下:

3、公司的技术发展水平、核心竞争力、业务拓展情况

公司专注于传感器封装核心技术服务,拥有WLCSP、TSV等先进封装工艺超过12年的技术积累,拥有8寸、12寸晶圆级封装技术,LEGA-MODULE等芯片级封装技术,2018年自主研发推出FANOUT技术,以上技术均能使公司成为领域的晶圆级封装芯片级的封装封装技术服务商。

公司的核心竞争力是独特的技术自主知识产权及商业应用能力。2006年公司成功引进WLCSP技术,在手机摄像头产品上实现规模化量产,自主研发了智能手机芯片级封装技术,满足客户不断提升的需求与工艺挑战,自主研发THINPACK技术,获得市场与客户认可,2015年,自主研发指纹识别封装技术,成功将晶圆级封装技术拓展到新的传感器领域,2014年,开发12英寸晶圆级封装技术,并建成全球第一条12英寸晶圆级封装产线,2014年,实施对终端达资产和业务并行的并购,获得芯片封装与模组集成封装方面的技术、工艺能力;2015年开始自主开发FANOUT技术,以满足高端、大尺寸影像传感器芯片的市场需求,实现规模化量产。与此同时,公司汽车电子应用领域已开发多年,并已通过了客户的认证流程。在3D深度识别领域封装技术积累和沉淀,以定制软件开发为结构,TOF等不同应用方向的封装工艺与器件制造能力。

公司具备晶圆级封装芯片级的综合封装封装服务能力,具有技术持续创新的研发能力,业务拓展应用领域涵盖影像传感器、指纹传感器主要应用领域。虽然在汽车电子、3D深度识别等新应用领域尚未形成量产销售,但公司在进行积极有效的拓展与布局,技术发展水平、核心竞争力、业务拓展情况等不是公司主营业务下滑的原因所在。

4、经营模式、销售及采购方式

公司所处行业主要包括芯片设计、晶圆制造、封装测试几个主要环节。公司作为专业的封装服务提供商,经营模式为客户提供晶圆级或芯片级委托封装,承接客户订单并制定月度生产任务计划,待客户将晶圆级的晶圆发到公司后,公司向原厂采购原材料,由生产部门按照技术标准组织芯片封装与测试,封装完成及检验后再将芯片交付给客户,并向客户收取封装测试加工费。

销售方面,公司主要向客户提供芯片设计、晶圆制造、封装测试服务。芯片设计是公司主要负责芯片电路功能设计与芯片产品销售,其本身无晶圆制造工厂和封装测试厂。芯片设计完成芯片设计,交给晶圆代工(Fab)晶圆制造公司,晶圆芯片完工后交付给客户,由公司组织设计、封装测试。公司与某些客户建立合作方式,一般会签署委托加工框架合同,具体的委托加工事项一般与客户每批次下达的加工订单确定,加工订单中明确当期加工的工数量和销售价格。

采购方面,公司采购当期境内国外供应商采购生产所需原材料,具体为由生产计划部门根据客户订单量确定加工计划,并制定原材料采购计划与清单,采购部门根据采购计划与清单直接向国内外供应商进行采购,并跟踪物流发货情况,材料到货后由质保部门负责检验,检验合格后再入库由生产领用。公司与供应商建立了长期的合作关系,根据市场状况不定期定价,不是公司主营业务下滑的原因。

5、公司的毛利率变动情况

智能手机行业进入存量市场后,公司业务面临的市场竞争激烈程度不断上升,从而使得公司产品与市场价格竞争压力加剧,产销价格下降,销售规模和毛利下降。

2018年公司主营业务毛利率由2017年的36.81%下降至27.85%,主要原因系产品单价下滑所致,其中,2018年8寸手机影像传感器芯片和指纹识别芯片的封装单价较年初分别下降了26%、18%。毛利率下滑导致公司主营业务盈利能力下降。

综上所述,公司2018年主营业务下滑的主要原因是在近年智能手机出货量下降,智能手机行业与手机市场存量市场竞争加剧,使得公司产品销售和毛利率出现下滑所致。如果未来智能手机产业发展趋势出现好转,可能会使公司的营业收入与毛利有所回升,敬请投资者关注。

问题2、年报披露,我国集成电路产业保持快速发展,业务收入同比增长达22.9%。公司于2014年上市后业绩出现波动,扣非归母净利润总体处于下滑态势。2014-2018年分别亏损1.61亿元、5.07亿元、5.12亿元、6.29亿元、5.64亿元,扣非归母净利润分别为1,68,407,304、-1,034,068,025元。此外,2018年度公司主要依靠非主营业务收入盈利,其中利息收入、汇兑净收益、政府补助分别为2824.30万元、389.39万元和6904.23万元,合计1.01亿元,占净利润比重为142.26%。请公司补充披露:(1)公司上市以来,主营业务收入、毛利率水平、政府补助等非主营业务收入的变化并予以同行业对比;(2)业绩波动变化与行业趋势差异的原因,公司面临的风险或困境及其对公司当期及未来经营业绩的影响;(3)上市以来政府补助等非主营业务收入对净利润的影响,是否可替代,并予以风险提示。

回复说明:

1、公司上市以来,主营业务收入、毛利率水平、政府补助等非主营业务收入的变化并予以同行业对比除本公司外,集成电路封装测试行业上市公司有长电科技、华天科技、通富微电、台湾精材科技(台股代码:2318)。下表为公司2014年以来主营的营业收入、毛利率和政府补助的变化及与同行业上市公司对比的情况:

项目	公司	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入(万元)	晶方科技	42,544.26	62,877.96	51,239.04	57,571.84	61,581.03
	精材科技	74,101.19	89,694.29	83,902.94	96,342.24	96,352.54
	长电科技	1,808,534.39	2,385,514.21	1,945,527.17	1,080,732.68	642,827.33
	华天科技	555,919.83	700,988.71	510,450.78	387,401.71	300,548.17
	通富微电	548,002.21	651,925.52	459,165.67	322,190.31	209,068.58
毛利率(%)	晶方科技	27.26	37.20	32.22	35.82	32.22
	精材科技	-6.26	-8.57	-7.62	14.17	19.22
	长电科技	12.32	11.71	11.82	17.83	21.13
	华天科技	17.06	17.46	18.04	20.52	21.89
	通富微电	16.16	14.90	18.00	21.80	19.08
利润总额(万元)	晶方科技	3,393.08	10,555.99	5,698.25	13,995.72	22,339.49
	精材科技	-33,353.05	-16,715.96	-15,870.90	4,231.73	12,888.35
	长电科技	9,933.80	23,997.40	-25,097.09	-11,229.30	25,791.05
	华天科技	43,300.47	63,114.46	47,834.56	37,716.38	34,824.66
	通富微电	17,734.58	17,776.95	24,379.63	16,182.07	13,421.76
当期确认的政府补助(万元)	晶方科技	1,577.79	2,742.46	1,806.19	4,806.10	2,783.72
	精材科技	-	-	-	-	-
	长电科技	12,152.69	28,744.63	20,675.01	5,989.20	4,411.74
	华天科技	5,903.26	8,151.00	7,218.17	12,423.84	6,503.10
	通富微电	4,992.29	12,375.25	9,443.48	13,721.55	8,945.19
当期确认的政府补助占利润总额的比例	晶方科技	40.61%	25.98%	31.70%	36.15%	12.46%
	精材科技	-	-	-	-	-
	长电科技	121.72%	119.99%	-82.38%	-48.97%	17.11%
	华天科技	13.63%	12.91%	15.09%	32.94%	18.67%
	通富微电	28.15%	69.61%	18.47%	84.79%	66.65%

注1:精材科技的财务数据已转换为人民币。  
注2:可比公司近期数据均转换为:2015年8月、长电科技收购金时利100%股权,金科金时利2016年和2017年营业收入分别为780,721.71万元和786,414.39万元;2016年1月,通富微电收购苏州和通富超威城城各85%股权比例,通富超威城苏州和通富超威城2017年营业收入分别为295,533.12万元。

注3:当期确认的政府补助对净利润总额的比例,对应比值为政府补助/利润总额,长电科技2015年、2016年因与净利润总额均为负数,所以数据为空。

(1)营业收入变动情况

长电科技、华天科技和通富微电为国内封装测试综合服务商,封装工艺多样化,封装产品及应用领域广泛,下游市场广阔,网络通信、消费电子、工业自动化控制、电源管理等领域。受益于产业并购及行业应用广泛,长电科技、华天科技、通富微电的工业收入规模呈上升趋势。

公司与精材科技为全球主要的两家为传感器领域提供晶圆级封装封装技术服务的公司,封装服务商,两者封装技术类似,均以晶圆级封装技术为核心技术,市场应用范围类似,封装产品以手机为代表的消费电子市场,产品应用主要集中在摄像头、指纹传感器等产品。当前形势下,智能手机近年来出现市场增速放缓,2018年甚至出现负增长的产业环境,导致市场竞争压力逐渐加剧,2014年以来公司和精材科技的营业收入保持持续下降。

(2)毛利率变动情况

从表中可以看出,几家上市公司的毛利率均呈现下滑的态势,其中,精材科技与公司智能手机行业增速放缓的外部环境影响,市场竞争压力加剧,由此造成毛利率水平逐步下滑。

此外,集成电路封装行业上市公司综合毛利率水平在10%-20%之间,公司综合毛利率水平相对较高,一方面原因是公司为全球领先的晶圆级芯片尺寸封装技术(WLCSP)服务提供商,WLCSP技术独特的封装方式,在封装成本方面有较强的竞争优势,另一方面原因是封装模式有一定关系,公司与客户的结算模式为:客户将芯片委托公司提供封装,公司将芯片封装完成后交付给客户,并向客户收取封装服务费,芯片本身的价值并不作结算,公司将封装服务费确认为公司的销售收入。

(3)政府补助

集成电路产业是国家经济和社会发展的战略性新兴产业,是培育发展战略性新兴产业、推动信息和工业化深度融合的核心与基础,是转变经济发展方式、调整产业结构、保障国家信息安全的重要支撑,战略地位日益显现,为此国家高度重视和大力支持集成电路产业的发展。

长电科技、华天科技以及通富微电和公司同属于集成电路封装行业,近年来均得到集成电路产业政策及政府补助的支持,每年确认的政府补助收入较大,总体而言,公司确认的政府补助金额相比而言规模较小。

2、业绩整体变化与行业趋势差异的原因,公司面临的风险或困境及其对公司当期和未来经营业绩的影响:

封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片等产品,主要应用于手机摄像头与指纹传感器等领域。

2018年中国集成电路产业整体保持高速增长态势,但在整体快速发展态势下,产业与市场呈现出现一些结构性的变化,随着智能手机普及率的上升及革命性的技术创新,以智能手机为代表的消费电子行业进入了存量市场态势。

根据Strategy Analytics发布的研究报告指出,2018年全年智能手机出货量下滑3%,国内国内手机出货量虽略有增加,同时,指纹识别芯片的应用范围与前景受到智能手机出货量的拖累,基于此产业环境和公司的主要业务产品应用领域、指纹传感器产品领域,市场竞争压力日渐激烈,业务规模出现下滑,主营业务收入较2017年降低了2,655万元,下降比例为9.95%。

综上,公司业务变化主要是全球智能手机市场趋势所致,针对上述市场风险不利产业环境,公司一方面努力巩固现有主营业务与产业地位,同时积极拓展新兴应用领域,在汽车电子、3D深度识别等应用领域不断加强推广,技术投入与研发不断,希望取得新的业务增长机遇。

3、上市以来政府补助等非主营业务收入对净利润的影响,是否可持续,并予以风险提示。

公司2014年以来上市以来的净利润收入分别为2,784.71万元、4,806万元、1,806万元、2,742万元、6,994万元,占当期利润总额的比例分别为31.42%、36.15%、31.70%、25.98%、36.15%。

公司获得的政府补助收入主要源于公司承担的三个国家科技重大专项一02专项的项目资助,通过专项

的资助与实施,公司一方面获得了相应的项目研发资助,相关资助在项目实施期间按实施计划进行使用,并确认作为公司的研发费用支出,计入管理费用。更为重要的是通过项目资助,推动了公司的技术持续自主创新,整合集成了产业链资源与集成化优势,为后续公司依然会持续加大研发投入,积极申请国家重大科技专项项目,但限于国家重大科技专项项目的立项及审批程序,需经国家重大科技专项办公室、国家科技部、财政部的相关审批程序,能否继续获得项目资助具有不确定性,敬请投资者关注。

问题3、年报披露,报告期内晶圆级封装封装量上年减少11.53%,库存量增加63.17%,非晶圆级封装封装量上年增加25.48%,库存量减少49.22%。请公司补充披露:(1)结合主要客户需求、产品竞争力、应用范围,2018年第二季度成功应用于影像传感器、指纹传感器,增加了公司在非晶圆级封装的封装出货量,非晶圆级封装业务的整体毛利率为26.89%,与晶圆级封装业务及公司整体综合毛利率无明显差异。

2、公司的技术发展水平、核心竞争力、业务拓展情况

公司专注于传感器封装核心技术服务,目前为全球领先的晶圆级芯片尺寸封装服务提供商,拥有8寸、12寸晶圆级封装技术,具备从晶圆级到芯片级封装的一站式综合封装服务能力,并拥有传感器领域领先的、完善的知识产权体系与专利布局,公司在晶圆级封装领域的行业地位、技术及竞争力未发生变化,其业务整体毛利率主要受智能手机市场整体下滑的产业环境影响所致。

3、2018年期末存货变动情况

2018年末公司存货账面金额为7,018万元,较上年末存货金额下降了282万元,整体库存未发生重大波动。

2018年末公司晶圆级封装产品的库存量较上年末未增长较多,主要原因是由于公司为增强与客户的合作粘性,延伸了测试服务能力,以满足客户需求,在结算模式上,公司将部分订单在封装服务完成后,先行对客户收取封装费,待测试完成后向客户交付产品,再将封装与测试费用计入收入。截止2018年末,尚未交付的已封装未测试产品增多,使得公司期末存货账面金额有所增加,预收款项余额也相应增加。

问题4、年报披露,本年度公司设计业务收入占整体比重为34.1%,为1932.23万元,同比增长399.14%,毛利率较83.88%。请公司补充披露设计业务收入的具体经营情况及核心竞争力,主要应用领域、主要客户名称、业务开拓方式等,并分析上述业务是否具有可持续性。

回复说明:

公司设计业务收入主要是对芯片封装工艺及其材料、设备的应用要求进行的开发设计所取得的收入,系公司后续封装业务实现量产的基础与有效拓展方式,但没有业务捆绑关系。

公司封装工艺模式的开展系基于公司对晶圆级封装技术、传感器芯片封装需求的积累与理解,为客户提供定制化封装工艺、材料与设备选型及性能提升等开发设计方案,以满足不同终端应用产品对封装工艺、材料与设备需求及性能的相关要求,并针对上述产品的工艺与材料。

公司设计业务的主要客户包括芯片设计公司、封装设备及材料公司等,主要客户情况及公司提供的封装开发服务情况如下:

客户	金额(万元)	设计开发内容	是否关联方	是否为封装业务前五大客户
客户1	1,381.13	汽车电子产品自动光学检测检测工艺、汽车电子产品金属键合工艺、纳米制程工艺、2D/3D视觉检测、Chip to Substrate (贴片与键合)工艺等	否	否
客户2	292.45	大芯密键合晶圆制造工艺、指纹传感器晶圆芯片与基板研磨抛光工艺等	否	否
客户3	90.68	测试工艺及设备参数测试调测	否	否
客户4	45.33	图像传感器封装工艺	否	否
客户5	24.33	指纹键合组与封装工艺	否	否

公司设计业务的核心竞争力来源于公司在晶圆级封装领域的技术积累与创新能力,对技术与应用领域产品属性、工艺窗口、设备与材料性能要求、创新趋势的理解,与前述描述的公司整体核心竞争力一致。自上市以来,公司设计业务的营收情况如下:

项目	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年
设计业务收入(万元)	1,932.23	387.11	1,099.69	425.97	363.09
设计业务收入占比	31.51%	60.90%	20.60%	12.00%	21.04%
毛利率(%)	83.88	84.27	77.67	97.18	94.20

如上表,公司上市以来一直提供封装方案及相应需求的设计服务,并取得相应的服务收入,设计业务收入规模整体呈现上升趋势,业务具有可持续性。

问题5、年报披露,公司前五名客户销售收入40,418.63万元,占年度销售总额71.38%,客户集中度较高;其中前五名客户销售收入占关联方销售总额1,653.57万元,占年度销售总额16.19%,占年度营业收入总额6,958.58万元,占年度营业收入总额33.06%。请公司补充披露上述3年前五大客户及供应商、交易金额、关联关系和主要销售或采购合同,结合收入和采购的依赖性,说明公司是否存在大客户或供应商依赖及关联关系。如上述客户或供应商销售或采购情况出现重大变化,请予以必要的解释说明。

回复说明:

1、2016年度-2018年度公司前五大客户销售情况

年度	序号	客户	销售金额	销售占比	销售产品	是否为关联方
2016年度	1	A客户	19,695.06	38.44%	封装服务	是
	2	B客户	6,016.74	11.74%	封装服务	否
	3	F客户	3,328.05	6.50%	封装服务	否
	4	E客户	3,598.33	7.02%	封装服务	否
	5	G客户	3,437.06	6.71%	封装服务	否
小计		36,075.25	70.41%			
2017年度	1	A客户	13,685.13	21.76%	封装服务	是
	2	B客户	10,058.52	16.00%	封装服务	否
	3	E客户	8,482.66	13.49%	封装服务	否
	4	D客户	5,732.72	9.12%	封装服务	否
	5	C客户	5,677.91	9.03%	封装服务	否
小计		43,636.94	69.40%			
2018年度	1	A客户	9,165.57	16.19%	封装服务	是
	2	B客户	8,938.63	15.79%	封装服务	否
	3	C客户	8,277.73	14.62%	封装服务	否
	4	D客户	7,119.56	12.57%	封装服务	否
	5	E客户	6,917.14	12.22%	封装服务	否
小计		40,418.63	71.38%			

2016年度、2017年度和2018年度,公司前五大客户合计销售金额占当年营业收入的比例分别为70.41%、69.40%和71.38%,客户集中度相对较高,这与公司下游客户所处行业的竞争格局有关,公司主要为影像传感器等芯片提供晶圆级封装服务,主要客户为影像传感器芯片设计公司,根据Yole的公开报告,2017年全球CMOS影像传感器的市场前五大的市场占有率为81%,行业集中度相对较高,由此造成公司的客户集中度也相对较高,全球影像传感器知名企业索尼、豪威科技、格科微均为公司客户。

2016年度,基于7寸和8寸晶圆级封装五大客户出现较大变化。近三年公司对关联方A客户的销售收入下降,一方面是高于前述的市场环境变化,同时A客户为全球领先的影像传感器芯片设计公司,近几年不断加大汽车电子用影像传感器的产能,虽然公司一直在努力推进汽车电子领域的拓展与应用,并在2018年第三季度通过认证稽核,但目前处于量产爬坡阶段,尚未实现量产。公司与客户交易的定价依据为成本加成原则,对关联方的定价规则与其他客户一致,近三年公司与关联方A客户的交易单价与其他客户交易单价类似,交易定价不存在重大差异。

公司不存在单个客户销售金额超过公司营业收入50%的情形,不存在大客户依赖的情形。

2、2016年度-2018年度公司前五大供应商采购情况

年度	序号	供应商	采购金额	采购占比	采购产品	是否为关联方
2016年度	1	A供应商	1,507.74	9.08%	贴膜玻璃	否
	2	F供应商	1,040.62	6.27%	光阻胶	否
	3	G供应商	966.43	5.82%	硅晶片粘胶剂	否
	4	C供应商	701.47	4.22%	基板	否
	5	D供应商	684.17	4.12%	显影液	否
小计		4,900.42	29.51%			
2017年度	1	A供应商	1,430.58	6.45%	贴膜玻璃	否
	2	C供应商	1,318.50	6.05%	基板	否
	3	F供应商	1,053.92	4.79%	光阻胶	否
	4	D供应商	916.88	4.17%	显影液	否
	5	E供应商	903.30	4.11%	防护材料	否
小计		5,623.48	25.57%			
2018年度	1	A供应商	1,924.50	9.14%	贴膜玻璃	否
	2	B供应商	1,525.36	7.25%	晶片薄片	否
	3	C供应商	1,333.26	6.33%	基板	否
	4	D供应商	1,250.67	5.94%	显影液	否
	5	E供应商	924.79	4.39%	防护材料	否
小计		6,938.58	33.06%			

由上表,2016年度、2017年度和2018年度公司前五大供应商采购金额占当年营业收入的比例分别为29.51%、25.57%和33.06%,向单一供应商采购金额不大,不存在向单个供应商采购比例超过公司采购总额50%的情形,不存在供应商依赖的情形。

问题6、公司目前无实际控制人,部分股东存在较高质押,请公司补充披露:(1)结合高质押股东及委委等,分析股东质押或变动对公司经营发展、业务开拓、技术创新以及经营业绩的影响;(2)结合公司上市以来主营业务发展情况,分析是否具有明确可行的稳定生产经营、促进业务发展的措施。

回复说明:

1、结合高质押股东及委委等情况,分析股东质押或变动对公司经营发展、业务开拓、技术创新以及经营业绩的影响:

公司自上市以来,股权结构保持相对稳定,如下为公司上市前及2018年末前十大股东的对比:

上市前					截至2018年末前十大股东				
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)				
EIPAT	66,844,336	35.27	中新创投	55,048,276	23.51				
上海新创投	55,048,276	29.05	EIPAT	33,890,269	14.87				
OmniH	35,388,178	18.68	天基金	21,677,753	9.26				
美国中芯	15,728,079	8.30	中金资本金融股份有限公司	5,754,639	2.46				
普华永道	4,475,000	2.36	普华永道	4,277,819	1.83				
GILLAD GAL-OR	4,128,621	2.18	GILLAD GAL-OR	3,505,230	1.50				
盛源咨询	3,785,000	2.00	OmniH	2,937,855	1.29				
弘福投资	1,908,602	1.01	普华永道	2,870,084	1.23				
晶方科技	1,240,000	0.65	中华汇金资产管理有限责任公司	2,829,300	1.21				
普华永道	953,908	0.50	普华永道	2,427,529	1.04				

2017年12月29日,大基金协议受让EIPAT持有公司1,677.75万股股份(占公司股份总数的9.32%)。大基金将在公司经营发展和业务开拓中发挥其在国家集成电路产业中的引领作用,助力公司成为全球领先的传感器芯片设计与制造企业,进一步提升公司技术创新引领能力,推动公司业务应用规模与产业链布局。

公司上市以来,董事会结构保持相对稳定,上市时,公司由6名董事组成,其中EIPAT委一名,中新创投委两名,OmniH和英菲尼迪-中新创投各委一名,公司董事长与董事均为共同委委。截至本问询回复披露日,EIPAT和中新创投的委委情况未发生变化,OmniH和英菲尼迪-中新创投均为持股比例变化,不再委委持股,由大基金委委一名董事和新增一名共同委委持股。各股东在董事会中的分配自上市以来保持稳定稳定,股东质押或变动不影响公司董事的稳定性。

公司上市以来,高管团队结构保持相对稳定,公司于2014年上市以来,除两名高管因退休四个人原因离开之外,其余高级管理人员均继续在公司任职。股东质押或变动未影响公司高级管理人员的稳定性。

综上所述,公司股东质押或变动对公司经营发展、业务开拓、技术创新以及经营业绩的影响,亦未对公司发展、业务开拓、技术创新以及经营业绩带来重大不利影响。

2、结合公司上市以来主营业务发展情况,分析是否具有明确可行的稳定生产经营、促进业务发展的措施

公司专注于传感器领域的先进封装技术服务,拥有有效影像智能手机为代表的消费电子产业发展,发展成为领先的传感器芯片封装技术服务商,上市以来,随着智能手机行业由增量市场转为存量市场的变化趋势,公司主动积极应对,努力寻找新的市场机遇与转型升级,具体措施如下:

(1)巩固现有影像传感器与指纹业务。针对影像传感器芯片市场,通过降低封装成本、